

# BUSINESS REPORT 2023



Copyright (C) 2023 Fujimi Incorporated. All rights reserved.  
Printed in Japan



# 技術を磨き、心をつなぐ

Polishing our technologies and bringing people together

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとしたさまざまな産業で活かされています。

フジミはお客様にあらゆる製品を磨いていただくことで、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

Our polishing technologies are utilized in the semiconductor industry and various other industries.

By enabling our customers to polish their products, Fujimi is helping to build a more comfortable future for all.



## CONTENTS [目次]

あいさつ Message	1	暮らしの中のFUJIMI Fujimi's Products and Technology in Everyday Life	19
経営方針 Corporate Policy	3	10年間の財務サマリー Ten-Year Financial Summary	21
中長期経営計画 Medium & Long Term Business Plan	4	経営指標 Selected Financial Data	23
事業紹介 Business	6	連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheet	25
コーポレート・ガバナンス Corporate Governance	13	連結損益計算書 Consolidated Statement of Income	27
環境への取り組み Environmental Measures	15	連結包括利益計算書 Consolidated Statement of Comprehensive Income	28
両立支援・女性活躍推進への取り組み Work-Life Balance Support and Promotion of Women's Career Activities	16	連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statement of Cash Flows	28
フジミのものづくりと社風・風土 Fujimi's Manufacturing and Corporate Culture	17	沿革 History	29
グローバル展開 Global Expansion	18	会社データ Corporate Data	30

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルスの世界経済へ与える影響が収束しつつあるものの、国際情勢の悪化を背景にした資源・エネルギー価格の高騰による物価上昇は継続しました。また、欧米の連続的な大幅利上げに加えて、米国の銀行破綻、欧州の銀行経営不安など世界の金融市場が混乱したことで世界的な景気後退懸念が一層高まり、世界経済の不透明感は強まりました。

世界半導体市場は、PC、スマートフォン及びサーバー市場の低迷を受け、2023年3月期下期に半導体デバイスの生産及び在庫の調整が加速しました。一方で、シリコンウェハーは2023年3月期下期において小口径ウェハーの生産調整が強まったものの、概して高い稼働が続きました。

こうした状況下、2023年3月期の業績は、売上高58,394百万円(前期比12.9%増)、営業利益13,243百万円(前期比9.8%増)、経常利益13,595百万円(前期比8.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益10,594百万円(前期比15.7%増)となり、売上高・営業利益・経常利益・当期純利益はいずれも過去最高となりました。

トピックスとしまして、2024年3月期から2029年3月期の6年間で対象とする中長期経営計画を新たに策定しました。これまで築き上げた強固な財務基盤を背景として、研究開発とグローバルな製品供給体制の拡充並びに人材投資やESGに係る取り組みを積極的に推進してまいります。株主様への還元につきましても、目標とする連結配当性向を50%から55%に引き上げることといたしました。

また、2023年6月30日を基準日として当社普通株式を1株につき3株の割合をもって分割いたしました。株式の流動性を高めるとともに個人投資家の皆様に投資していただきやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

During the FY2023, despite the global economy has become less vulnerable to the spread of COVID-19 variant, the inflation pressure remained strong because of soaring resource and energy prices as a result of worsening international situation. The global economic uncertainty increased due to concerns about economic recessions caused by the consecutive interest rate rise in the US and Europe followed by the global financial market turmoil out of banking crisis in US and Europe.

In addition, the global semiconductor market has been experiencing the accelerated adjustment of production and inventory since the mid-2022 due to the downturn in the PC, smartphone and server markets. Although small diameter silicon wafer production adjustment started in the second half of FY2023, the silicon wafer production in general still kept high level.

The consolidated results for this period are shown below.

Consolidated Results for Fiscal Year 2023:				Millions of JPY
	FY ended March 31, 2022	FY ended March 31, 2023	Change YoY	
Net Sales	51,731	58,394	12.9%	
Operating Profit	12,059	13,243	9.8%	
Ordinary Profit	12,490	13,595	8.8%	
Profit Attributable to Owners of Parent	9,156	10,594	15.7%	

As a topic, the Company drew up our Medium & Long Term Business Plan, which is set to have the year ending March 31, 2029 as its final term. Based on the robust financial foundation that we have created to date, the Company will aggressively promote R&D and expansion of our global product supply chain, as well as investment in human resources and ESG initiatives. As one specific measure to boost shareholder returns, the Company is raising our consolidated dividend ratio target to over 55% to be accomplished by the year ending March 31, 2024.

In addition, the Company conducted a 3-for-1 stock split of its common stock with a record date of June 30, 2023. The purpose of this split is to increase the liquidity of the Company's shares and to create an environment that facilitates investment by individual investors, thereby expanding the Company's investor base.

The Company is grateful for your patronage and ask for your continued understanding and support.



代表取締役社長  
関 敬史  
Keishi Seki, President and CEO

# 経営方針

## Corporate Policy

### 企業理念 Corporate Philosophy

#### 【企業使命】

高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

#### 【経営姿勢】

- ・お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- ・一人ひとりが「働きがい」と「働きやすさ」を実感できる会社を目指します。
- ・経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- ・技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応えます。

#### 【行動規範】

- ・お客様の満足を常に考え行動します。
- ・問題の本質を追求し、迅速且つ確実に解決します。
- ・夢の実現に向け、熱意・誠意・創意をもってチャレンジします。
- ・一人ひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。
- ・良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。

### 企業ビジョン Corporate Vision

#### 【事業アイデンティティ】

パウダー&サーフェス分野で世界最高技術を提供し、私たちが理想とする「エクセレントカンパニー」を目指します。私たちが理想とする「エクセレントカンパニー」とは、業績が優れているだけでなく次の3つを実現する会社です。

- ・変化に的確に対応し、未来に向けて持続的に成長する。
- ・企業理念・ビジョンの実現に向け、一人ひとりが熱意と誠実さをもって、生き生きと仕事に取り組む。
- ・環境負荷低減とともに持続可能な社会の実現に貢献する。

#### 【企業文化ビジョン】

強く、やさしく、面白い会社を目指します。

- ・自由闊達で切磋琢磨する風土をつくります。(強く)
- ・仲間を大切に、助け合い、感謝します。(やさしく)
- ・夢をいだし、夢がかなう職場をつくります。(面白い)

#### 【事業構造ビジョン】

既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野(シリコン・CMP)と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します。

#### Corporate Mission

Our mission is to develop new, innovative technologies and applications with a commitment to environmental sustainability, thereby enabling the advancement of technology for the betterment of humanity.

#### Management Policy

- ・We adopt the customer's point of view to create solutions that meet the customer's needs and expectations.
- ・We aim to be a company that motivates employees to excel by creating a great work culture.
- ・We excel in the ever changing business environment by actively taking on new challenges and continuing to innovate.
- ・We adhere to rules and regulations and strive to improve the quality of our technologies and management thereby strengthening our stakeholders' confidence and trust.

#### Code of Conduct

- ・We act with customer satisfaction in mind.
- ・We strive to identify the root cause of an issue and resolve it quickly.
- ・We challenge ourselves to succeed with passion, sincerity and creativity.
- ・We respect each person's ideas and opinions.
- ・We conduct ourselves with pride, honesty and integrity.

#### Business Identity

We offer the world's highest level of technology in the powder and surface fields, and aim to be an "excellent company." Being an "excellent company" means more than excellent business performance. It means that we as a company achieve the followings three things.

- ・We proactively adapt to changes and strive for sustainable growth.
- ・Each person works with passion, enthusiasm, and integrity to achieve the corporate philosophy and vision.
- ・Contribute to the achievement of a sustainable society while reducing the environmental impact.

#### Corporate Cultural Vision

Fujimi will be a strong, kind and exciting company.

- ・Create an open climate conducive to friendly competition. (Strong)
- ・Respect, cooperate with, and appreciate colleagues. (Kind)
- ・Have a future plan, and form a working group to achieve that dream. (Exciting)

#### Business Structure Vision

Fujimi will strengthen its existing businesses while aggressively taking on challenges in new fields. We will construct a stable business that is balanced between the semiconductor (silicon and CMP) and non-semiconductor fields.

# 中長期経営計画

## Medium & Long Term Business Plan

当社は、2024年3月期を初年度とする6ヵ年経営計画を新たに策定いたしました。

#### 【基本方針】

当社は、企業使命である「高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します」に基づき、既存事業(半導体関連事業等)の更なる拡大と新たな柱となる新規事業の創出を通じて、研磨材メーカーからパウダー&サーフェスカンパニーへの進化を遂げ、持続可能な社会の実現への貢献を目指すことを基本方針としております。2024年3月期から2029年3月期の6年間を対象とする本計画では、研究開発とグローバルな製品供給体制の拡充に一層の経営資源を投入するとともに、サステナブルな経営の根幹を成す人材投資やESGに係る取り組みを積極的に推し進め、中長期企業ビジョン・スローガン「私たちは一人ひとりの前向きなアイデアとチャレンジを応援します」の実現に向け、各種施策に取り組んでまいります。

※中長期経営計画の詳細は当社ホームページよりご確認ください。

The Company drew up its 6-year business plan (the Plan) which starts from the current fiscal year ending March 2024.

#### Basic Policy

Based on its corporate mission "we will develop new, innovative technologies and applications with a commitment to environmental sustainability, thereby enabling the advancement of technology for the betterment of humanity", The Company will realize conversion from an abrasives manufacturer to "Powder & Surface" company by expansion of existing businesses (semiconductor-related business, etc.) and by creation of new businesses that will become new pillars of businesses, and will contribute to the achievement of a sustainable society. The Company has formulated the Plan covering the six-year period from the fiscal year ending March 31, 2024 to the fiscal year ending March 31, 2029, aiming;

- ・Further investment of its resources in R&D and expansion of global product supply chain.
- ・Active promotion of human resource investment and ESG initiatives as the basis of sustainable management.
- ・Realization of its mid to long-term corporate slogan "We support your forward-looking ideas and challenges".

\* Please refer to the Company website for details of the Plan.

### 定量目標 Quantitative Targets

目標項目 Target Item	FY2023	FY2026	FY2029
	実績 Actual	計画 Plan	計画 Plan
連結売上高 (億円) Net Sales 100 million JPY	583	770	950
新規事業売上構成比 New Business Sales Ratio	2.0%	15%	20%
非半導体売上構成比 Non-Semiconductor Sales Ratio	14.0%	20%	25%
非研磨分野売上構成比 Non-Polishing Sales Ratio	4.4%	8%	10%
営業利益率 Operating Profit Margin	22.7%	20%	20%
EBITDA マージン EBITDA Margin	25.6%	26%	27%
ROE	16.1%	15%	15%

# 事業紹介 Business

## 重要施策

1. 研磨材メーカーからパウダー&サーフェスカンパニーへの進化を実現する新規事業の創出
2. 半導体関連事業の強靱な基盤構築と次世代半導体向け材料分野での圧倒的な地位確立
3. コア技術の発展と新技術の開発
4. 100年企業を実現する GRIT（※）な組織と人づくりへの挑戦
5. サステナビリティ経営の実践

## マテリアリティ（重要課題）の特定

当社は本計画策定に際し、持続可能な社会の実現に向けて、当社が優先して取り組む重要課題として18のマテリアリティを特定しました。

マテリアリティを特定することで、自社が貢献すべき社会課題を認識し、課題への取り組みを進めてまいります。今後は社会動向・自社の取組状況を踏まえて、定期的にマテリアリティを更新する予定です。

## Major Measurement

1. Creation of new businesses that realizes conversion from an abrasives manufacturer to "Powder & Surface" company.
2. Building a robust foundation for semiconductor-related businesses and establishing an overwhelming position in the field of materials for next-generation semiconductors.
3. Reinforcement of core technology and development of new technology.
4. Challenge of developing GRIT\* organization and human resource that realize a 100-year-old company.
5. Implementation of sustainability management.

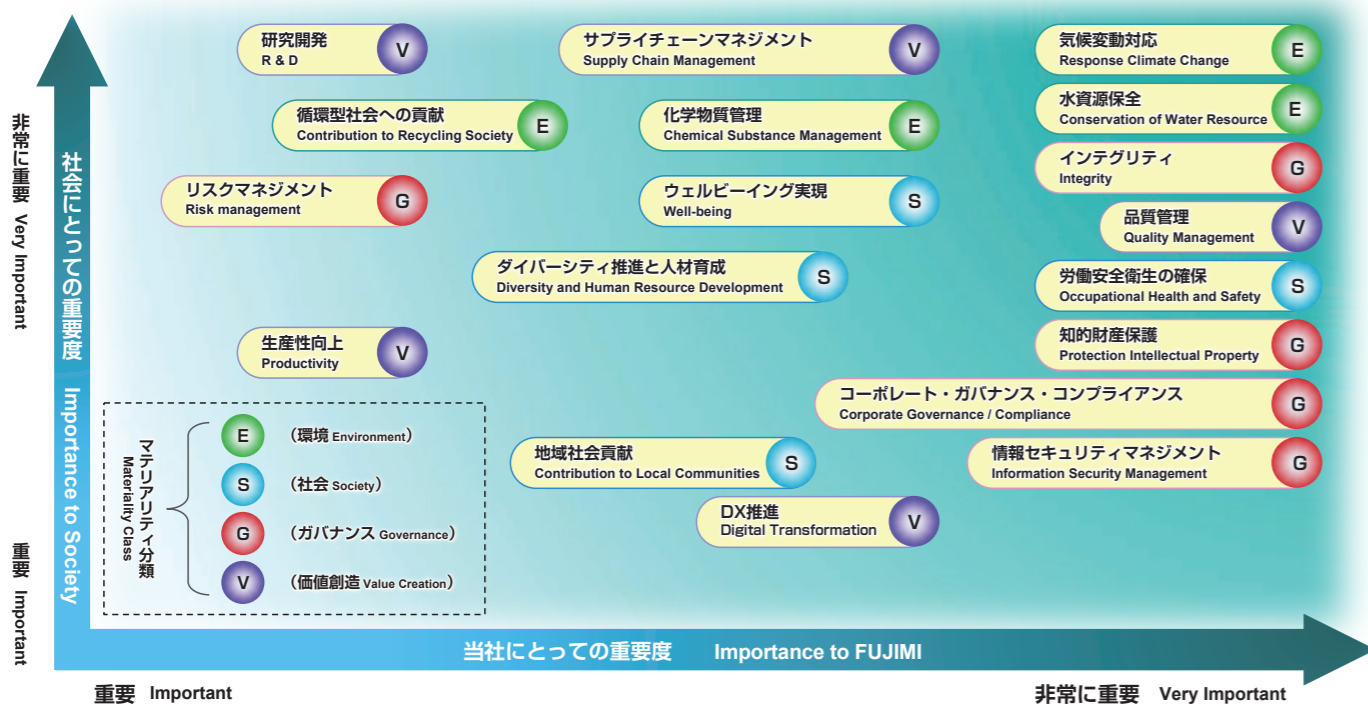
\*GRIT: courage and determination despite difficulty

## Specification of Materiality

In developing the Plan, the Company has specified 18 materialities ("Materialities") as important subjects/issues which the Company prioritizes for a sustainable society.

By specifying Materialities this time, the Company recognizes social subjects/issues to which the Company should contribute and address. The Company plans to update the Materialities on a regular basis based on social trends and the status of our own initiatives.

## マテリアリティ・マトリックス Materiality Matrix



当社の創業以来蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた製品の数々は、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP（化学的機械的平坦化）、ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっております。なかでも、主力事業分野である半導体基板向け超精密研磨材では世界ナンバーワンのマーケットシェアを維持しており、超精密研磨のリーディングカンパニーとして、市場優位性を維持しております。

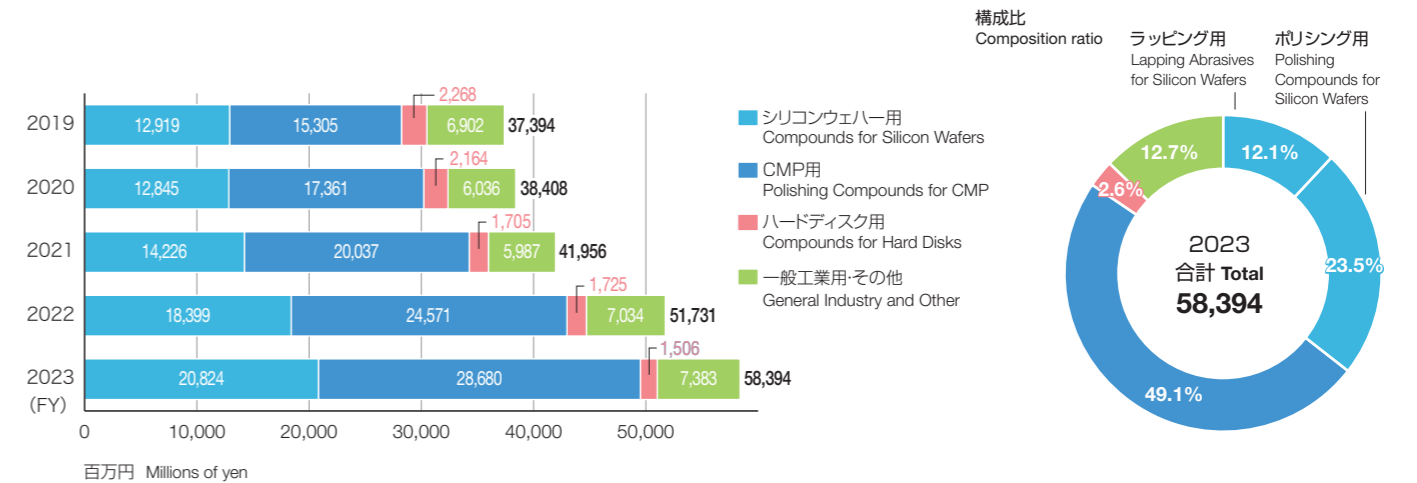
ここでは、当社の各事業と先端技術・機能材料本部をご紹介します。

Drawing on the know-how and R&D capabilities accumulated since its founding, Fujimi has developed numerous products essential for leading-edge industries with high-precision polishing needs, including mirror polishing of semiconductor substrates like silicon wafers, CMP (chemical mechanical planarization) required for the multilayer wiring of semiconductor chips, and hard disk polishing. In particular, Fujimi holds the top global market share for high-precision abrasives for semiconductor substrates, a core business area, and maintains its market superiority as the leading name in synthetic precision abrasives.

Here, we will introduce each of our business and Advanced Technology & Specialty Materials.

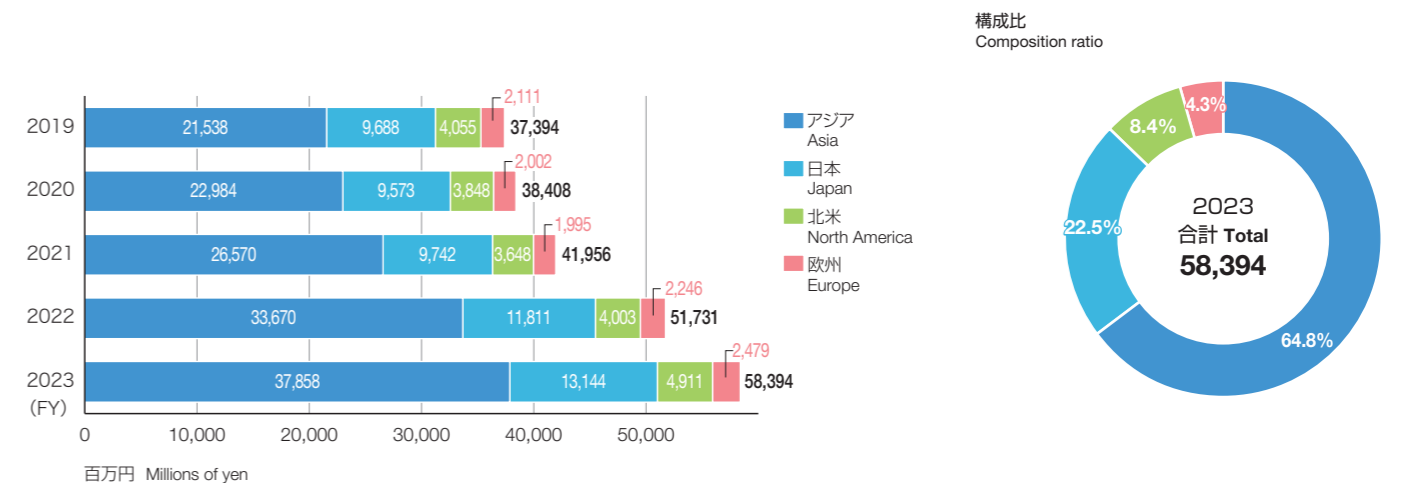
## 用途別製品売上高 Sales by Application

3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31



## 地域別売上高 Sales by Region

3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31



## シリコン事業 Silicon Business

半導体基板となるシリコンウェハーを高精度に平坦・鏡面化する研磨工程で用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。切断から仕上げ研磨までトータルソリューションを可能とする高品質な製品・サービスを揃えております。デザインルール  
の微細化に伴い、超精密研磨の要件である、①高平坦化、②高平滑化、③無欠陥化、④汚染低減、⑤生産性向上への要求はますます強くなっております。高度化するお客様の要求に応えるべく、引き続き新技術に支えられた独自性の高い新製品を提供し、「最も信頼されるパートナー」を目指してまいります。また、近年、電気自動車、ハイブリッド自動車の普及が進む中で、注目度が高まっているパワーデバイス基板向け製品開発にも注力し、米国及びマレーシア拠点で量産を開始しております。

In this business, the Company researches, develops, manufactures and sells abrasives that are used in the high-precision polishing process in which silicon wafers, which become semiconductor substrates, are flattened and mirror polished. The Company offers high-quality products and services by which a total solution for every step of the process from cutting to polish finishing can be achieved. As there is a further shrinking of design rules, requirements of super precise polishing for 1) high flatness, 2) low roughness, 3) defect free, 4) metal contamination free and 5) productivity improvement are getting stronger and stronger. The Company aims to become its customers' "most trusted partner" by continuing to provide highly distinctive new products supported by new technologies so that the Company can satisfy the increasingly sophisticated requirements of its customers. In addition, the Company is focusing on the development of products for power device substrates, which have received increasing attention in recent years with the spread of electric vehicles and hybrid vehicles, and have started mass production at its U.S. and Malaysian bases.

### 当社製品 Our Product

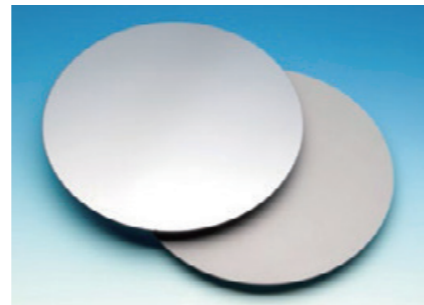


GLANZOX



FO

### 使用用途 Use Applications

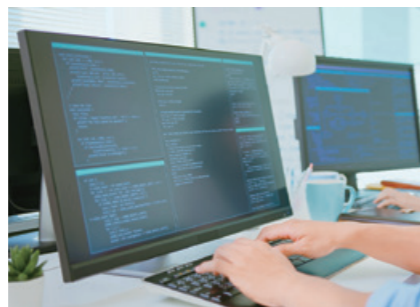


シリコンウェハー  
Silicon Wafer

### 最終用途 End Use



スマートフォン  
Smartphone



パソコン  
Personal Computers



電気自動車  
Electric Car

## CMP事業 CMP Business

半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。半導体デバイスの高性能化、高密度化、高集積化に伴い、研磨対象となる膜種とCMPが適用される工程は増加傾向にあります。当社では、多結晶シリコン薄膜用やCu配線形成用にポリシング材を開発しておりますが、CMPプロセスの用途拡大にあわせ、新たな研磨対象となる材料や構造に適用できるポリシング材の開発も始めております。お客様の製造・開発拠点に近い、日本、米国、台湾に製造・開発拠点を設け、お客様とより密接な関係を構築し、お客様のロードマップに沿った新製品を開発しております。

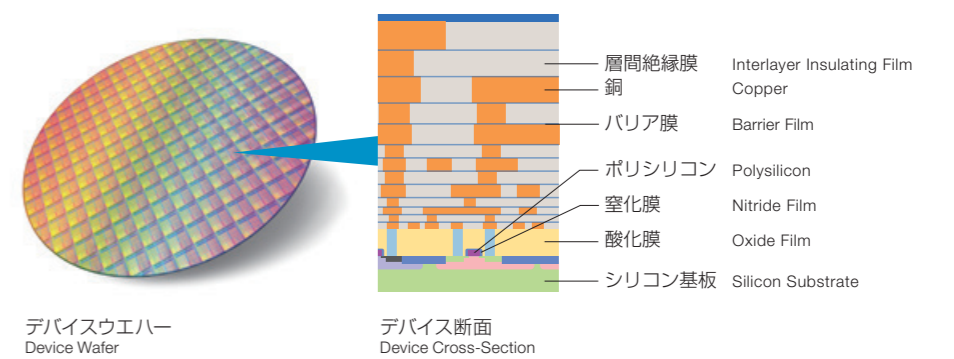
In this business, the Company researches, develops, manufactures and sells abrasives that are used in the manufacturing process of semiconductor devices. Types of films to be polished and the manufacturing process of semiconductor devices for which CMP is used are increasing as they have become more highly functional and highly-integrated products with higher density. Although the Company has already developed slurries for polycrystal silicon films and Cu wiring, the Company has also launched development of slurries that can be used with new materials and structures to expand the use of the CMP process. The Company has established manufacturing and development bases in Japan, the United States, and Taiwan, which are located near the manufacturing and development bases of its customers, thereby building closer relationships with customers and developing new products in accordance with customers' roadmaps.

### 当社製品 Our Product



PLANERLITE

### 使用用途 Use Applications



デバイスウェハー  
Device Wafer

デバイス断面  
Device Cross-Section

### 最終用途 End Use



スマートフォン  
Smartphone



データセンター  
Data Center



VRゴーグル  
VR Goggles

## ディスク事業 Disk Business

デジタルデータの記録媒体であるハードディスクドライブ用ディスク基板の製造工程に用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。お客様の生産拠点が集中するマレーシアに製造拠点を置くとともに技術スタッフを配置し、技術サポートを実施することでお客様との信頼関係を構築しております。クラウドサービスや5Gにより送受信されるデータ容量の増加が見込まれており、データセンター向けのハードディスク需要は短期的に調整局面を迎えておりますが、引き続き需要は継続していくものと思われれます。次世代ディスク基板への要求を早期に入手し具現化するため基礎開発の拡充も図り、お客様の要求に合った新製品をタイムリーに提供してまいります。

In this business, the Company manufactures and sells abrasives that are used in the manufacturing process of disk substrates for hard disk drives, which are storage media for digital data. The Company has a manufacturing base in Malaysia, in which its customers' production bases are concentrated, and the Company has built relationships of trust with its customers by allocating technical staff and providing technical support in the region. Although hard disk demand for data centers has experienced a short term adjustment phase, the demand is expected to continue due to anticipated increase in data capacity that is transmitted and received via cloud service or 5G, the Company endeavors to expand the areas of basic development in order to grasp customers' requirements for next-generation disk substrates at an early stage, thereby promptly providing new products that meet customers' requirements.

### 当社製品 Our Product



DISKLITE



FO

### 使用用途 Use Applications

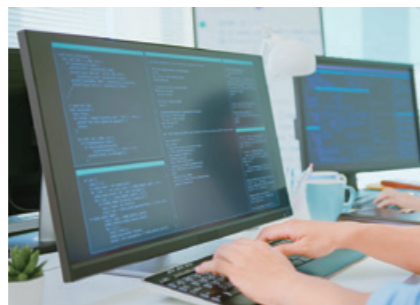


ハードディスク  
Hard Disk

### 最終用途 End Use



データセンター  
Data Center



パソコン  
Personal Computers



デジタルTV  
Digital TVs

## 研磨ソリューション事業 Polishing Solutions Business

様々な用途で用いられる、多種多様な材料（金属、樹脂、セラミック、複合材料等）や形状（2次元、3次元形状）に対応した研磨材等の研究開発及び製造販売を行う事業です。旧新規事業を改称のうえ、旧機能材事業から分離独立した研磨関連事業を統合し、一体運営を図っております。世界の様々な業界のお客様から寄せられる、新たな表面創成のご要望に、研磨材の供給のみに留まらず、用途に応じた様々な研磨方法を提案し、周辺消耗材や装置、受託加工までを含めたトータルソリューションでお応えしてまいります。

In this business, the Company researches, develops, manufactures and sells abrasives and other products for a wide variety of materials (such as metal, resin, ceramic, and composite materials) and shapes (two-dimensional and three-dimensional) for various applications. The Company has enhanced unified management by changing the name of the former New Business Division and integrating this business with polishing-related businesses, etc. that have been spun-off from the former Specialty Materials Division to become an independent division. The Company will continue to serve new surfacing requests of customers from various industries across the globe by not only supplying abrasives but also providing a wide range of polishing methods depending on the intended use, thereby offering total solutions, including everything from the recommendation of application-specific equipment and consumables, to the processing stage.

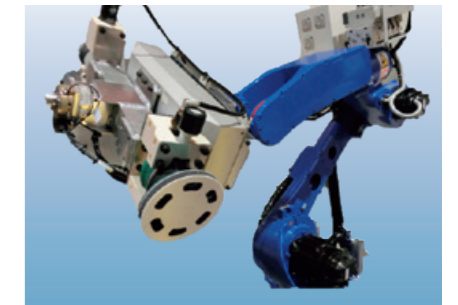
### 当社製品 Our Product



COMPOL

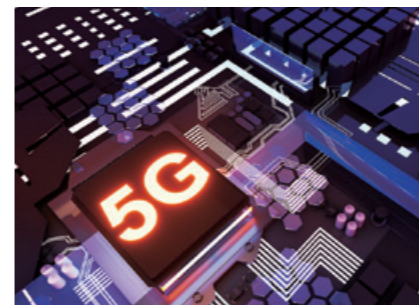


MIRAFLEX



ロボット研磨  
Robot Polishing

### 使用用途 Use Applications



通信デバイス  
Connectivity Semiconductor



自動車ボディ  
Automobiles Body



眼鏡レンズ  
Eyeglasses Lens

## 溶射材事業 Thermal Spray Materials Business

半導体装置、航空機及び鉄鋼など様々な業界の機械部材の長寿命化、高機能化を実現するために、環境に優しい表面処理として使用される溶射用途向けに、主にサーメット、セラミックスなどの溶射材を研究開発し製造販売する事業です。溶射プロセスでも近年、高効率化、高品質化へ向け、低温化、微粉化をキーワードとした新技術が注目を集めております。これら市場の期待に応えるべく、独自の粉末造粒技術を一層強化し、タイムリーなソリューション提案を行い、売上拡大を目指してまいります。

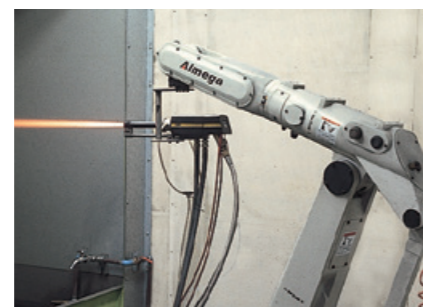
In this business, the Company mainly researches, develops, manufactures and sells thermal spray materials such as cermets and ceramics for thermal spray applications, which is environmental-friendly surface processing, in order to meet the demand for longer product life and higher product functions of machinery and components in a variety of industries including semiconductors, aircraft, and iron and steel. In recent years, attention has turned to new technologies where the keywords are "lower temperatures" and "micronization," as means for enhancing the efficiency and quality of thermal spray processing. In a move to meet these market expectations, the Company aims to increase sales by developing new markets through further reinforcing its unique powder granulation technologies and promptly offering solutions.

### 当社製品 Our Product



SURPREX

### 使用方法 Method of Use



溶射ガン  
Thermal Spray Gun

### 最終用途 End Use



半導体製造装置  
Semiconductor Manufacturing Equipment



鉄鋼  
Steel



自動車部品  
Auto Parts



製紙用機械  
Paper Machine

## 先端技術・機能材料本部 Advanced Technology & Specialty Materials

パウダー領域・非研磨事業の拡充をさらに推進することを目的として発足した「先端技術・機能材料本部」傘下において、パウダー分野におけるフジミ基幹技術の研究開発を進めると同時に、非研磨分野における新規事業の「創出」と「事業化」を強力に推進してまいります。また、これまで機能材事業や先端技術研究所で養ってきた粒子形状・粒度分布制御及び造粒技術をはじめとする当社基幹技術を一体化させ、さらにマーケティング力を強化し、新規用途・お客様層の拡大に一層注力してまいります。

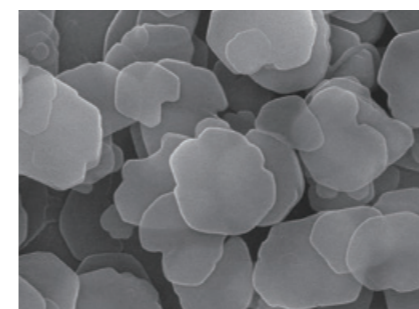
具体的な取り組みの一例として、高い放熱性と流動性を備えたセラミックスパウダー、軽量かつ高い放熱性を備えたセラミックス複合材料、高白色度でアスペクト比が制御された化粧品向け等の利用が期待されるリン酸チタンの新規パウダーや3Dプリンター用超硬材料等の開発を進めております。

In these areas, the Company will push forward with research and development of its core technologies in the field of powder under the Advanced Technology & Specialty Materials Division, which was established for the purpose of further promoting the expansion of the powder domain and non-polish businesses, while at the same time strongly promoting the creation and commercialization of new businesses in the non-polish field. In addition, the Company will put more focus on the expansion of new uses and customer segments by integrating its core technologies, including those for controlling particle shape and particle size distribution and granulation, that have been cultivated by its Specialty Materials Business and the Advanced Technology Research Center and by strengthening marketing power even further.

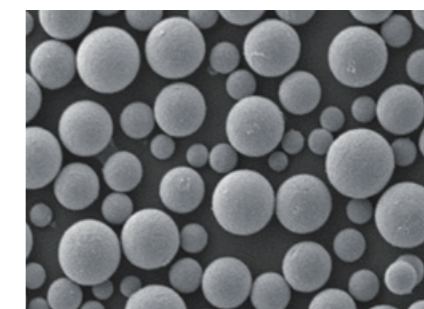
As examples of specific initiatives, the Company has developed ceramic powders with high heat dissipation and flowability, ceramic composite materials with lightweight and high thermal resistance, as well as new bright-white titanium phosphate powders with a low aspect ratio that are expected to be used in products such as cosmetics, and ultrahard materials for 3D printers.

### 当社開発（一例）

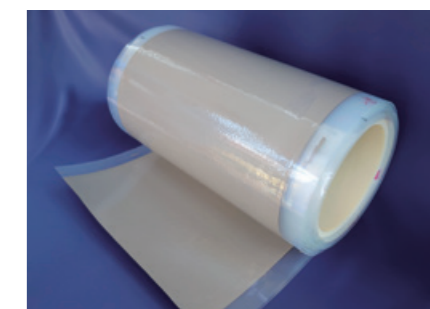
Developed By the Company (Example)



リン酸チタン粒子  
Titanium Phosphate Particles



球状 SiC 粒子  
Spherical SiC Particles



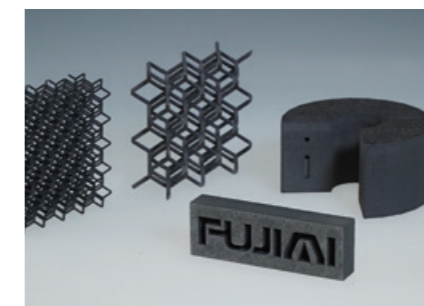
CMC (セラミックス複合材料) 中間製品  
CMC (Ceramic Matrix Composite) Intermediate Product

### 用途開拓

Application Development



化粧品材料  
Cosmetic Material



3D プリンティング  
3D Printing



航空機部材  
Aircraft Parts

# コーポレート・ガバナンス

## Corporate Governance

### 基本的な考え方 Basic Stance

当社は経営の効率を高め、意思決定の迅速化、機動性の向上を図ることにより企業価値を向上させることがステークホルダー全体の満足度を高めることにつながると考えております。そのためには、経営の健全性と透明性を高めることが必要であり、コンプライアンス（法令遵守）の徹底と経営監視機能の強化が重要であると認識しております。

当社では、法令は企業として最低限守るべきものとの考えから「倫理綱領」を制定しており、取締役及び従業員等全員がこの趣旨に従い、公正に行動することで「信頼のフジミ」であり続けたいと考えております。

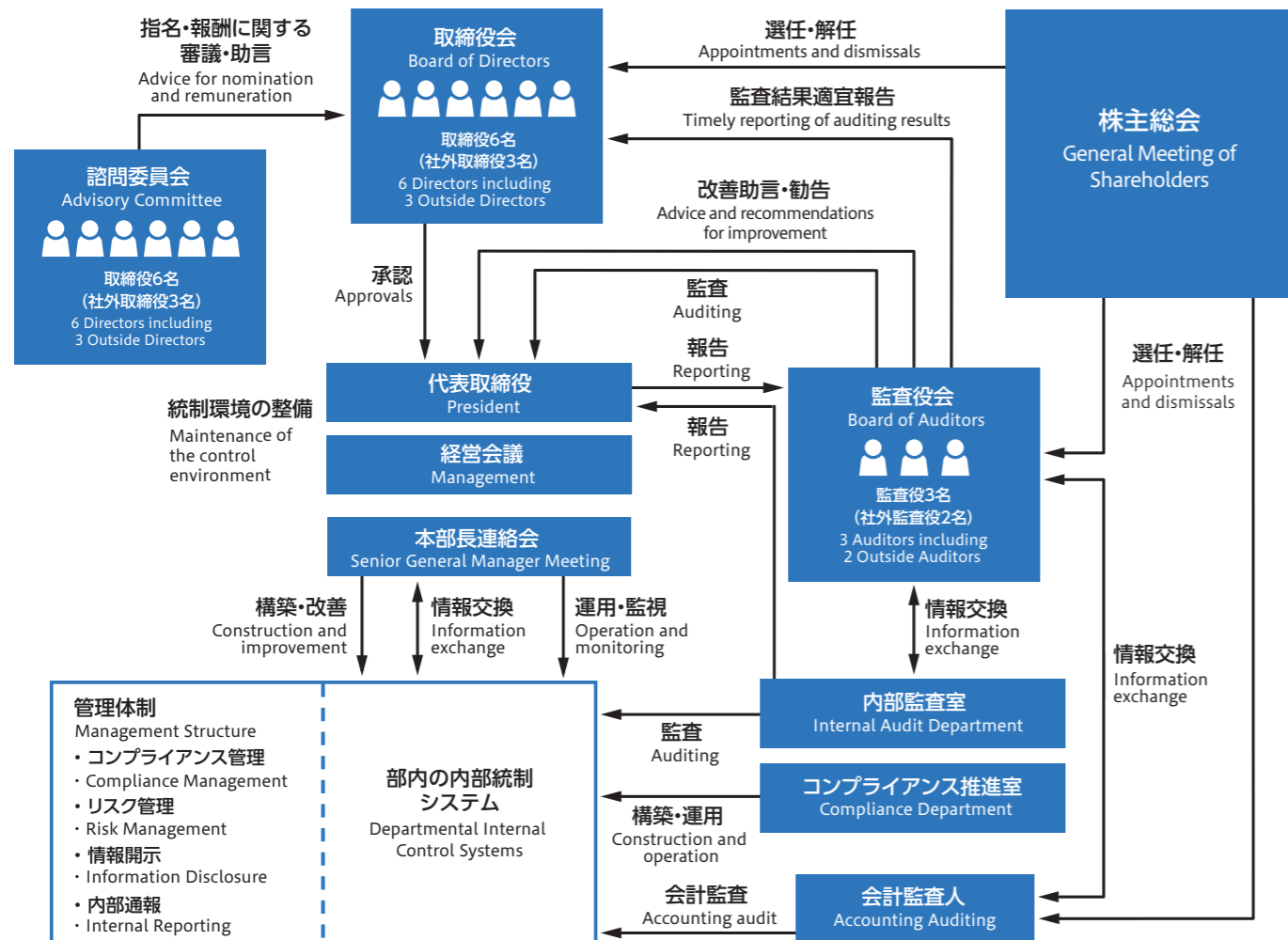
取締役及び管理職社員は、倫理綱領を実現することが自らの重要な役割であることを認識し、率先垂範のうえ関係者への周知徹底に努めております。また、倫理綱領に違反する事態が生じたときは企業を挙げて問題の解決に当たり、原因の究明と再発の防止に努めております。

We believe that increasing corporate value by improving management efficiency, speeding up decision-making and increasing mobility will lead to greater satisfaction of all stakeholders. In order to achieve this, we also believe that it is necessary to enhance the soundness and transparency of management, and we recognize the importance of thorough compliance and strengthening of the management monitoring function.

We have established the "Code of Ethics" based on the belief that laws and regulations should be observed at a minimum as a company, and we hope to continue to be "Fujimi - a company to trust" by ensuring that all directors and employees act fairly in accordance with this code.

Directors and managers understand the vital role which must be played in achieving adherence to our code of ethics. To this end, they will lead by example, ensuring greater awareness of the code's importance. Should violations of the code occur, every employee will work to identify the causes of the infractions, resolve the issues and prevent recurrences.

### コーポレート・ガバナンス体制図 Corporate Governance System



### 取締役及び監査役 (2023年6月22日現在) Board of Directors and Audit & Supervisory Board Members (As of June 22, 2023)

役職 Position	氏名 Name	重要な兼職の状況 Important Concurrent Positions
代表取締役社長 President and CEO	関 敬史 Keishi Seki	
常務取締役 Managing Director	大脇 寿樹 Toshiki Owaki	
常務取締役 Managing Director	鈴木 勝弘 Katsuhiko Suzuki	フジミコーポレーション会長、フジミ台湾董事長 Chairman of FUJIMI CORPORATION, President of FUJIMI TAIWAN LIMITED
取締役〔社外〕 Director [Outside]	川下 政美 Masami Kawashita	
取締役〔社外〕 Director [Outside]	浅井 侯序 Yoshitsugu Asai	アネスト岩田(株)社外取締役 ANEST IWATA Corporation Director [Outside]
取締役〔社外〕 Director [Outside]	吉村 温子 Atsuko Yoshimura	VG-C(株)代表取締役社長 VG-C K.K Representative Director and President
監査役 Corporate Auditor	藤川 佳明 Yoshiaki Fujikawa	
監査役〔社外〕 Corporate Auditor [Outside]	高橋 正彦 Masahiko Takahashi	高橋正彦事務所 公認会計士・税理士 Masahiko Takahashi Certified Public Accountant and Tax Accountant Office Director
監査役〔社外〕 Corporate Auditor [Outside]	岡野 勝 Masaru Okano	

### 取締役及び監査役の特長性 Specialties Board of Directors and Audit & Supervisory Board Members

	企業経営 Corporate Management	グローバル Global	事業開発 Business Development	営業・マーケティング Sales and Marketing	技術・研究開発 Technology and R&D	製造・品質管理 Manufacturing and Quality Control	財務会計/M&A Finance and Accounting/M&A	法務・リスク管理 Legal Affairs/Risk Management	人事・人材育成 Personnel and Human Resource Development	CSR/ESG CSR/ESG
代表取締役社長 関 敬史 Keishi Seki	●	●		●			●	●		
常務取締役 大脇 寿樹 Toshiki Owaki	●	●		●	●	●				
常務取締役 鈴木 勝弘 Katsuhiko Suzuki	●	●		●	●	●				
取締役〔社外〕 川下 政美 Masami Kawashita	●	●	●	●			●			
取締役〔社外〕 浅井 侯序 Yoshitsugu Asai	●	●	●				●		●	●
取締役〔社外〕 吉村 温子 Atsuko Yoshimura	●	●	●				●			
監査役 藤川 佳明 Yoshiaki Fujikawa								●	●	
監査役〔社外〕 高橋 正彦 Masahiko Takahashi							●			
監査役〔社外〕 岡野 勝 Masaru Okano	●		●		●	●			●	

# 環境への取り組み Environmental Measures

私たちは、企業活動のあらゆる面で環境に配慮した取り組みを行い、持続可能な社会の実現を目指しています。

## 環境方針 Environmental Policies

私たちは、環境マネジメントシステムを継続的に改善することにより、汚染の予防と環境負荷低減を推進し、環境保護と地球に優しい企業活動を実践します。

### 行動方針

1. 企業活動を通して省資源及び省エネルギーを推進します。
2. 汚泥等の廃棄物量を削減するとともに、リサイクルを推進します。
3. 排水中の汚染物質の低減活動を推進し、水質汚染の防止を図ります。
4. 当社に潜む環境リスクの低減活動を推進し、緊急事態の未然防止を図ります。
5. 環境負荷低減に寄与する商品とサービスを提供します。
6. 環境関連法規、その他の要求事項を順守します。

FUJIMI are undertaking initiatives that are considerate of the environment in various aspects of corporate activities with the aim of realizing a sustainable society.

Fujimi practices environmental protection and earth-friendly corporate activities by continual improvement of environmental management system to prevent pollution and to reduce impact on the environment.

### Action Guidelines

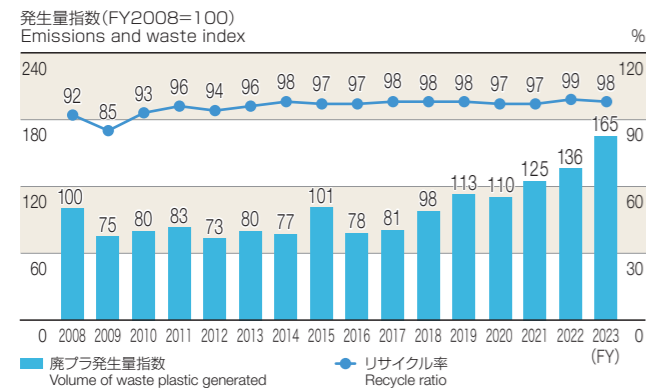
- 1.Promote the efficient use of resources and conservation of energy.
- 2.Reduce the volume of waste materials and promote recycling.
- 3.Prevent pollution in wastewater by reduction activities of pollutant.
- 4.Prevent emergency situation by reducing activities of potential environmental risks in Fujimi.
- 5.Provides products and services with less impact on the environment.
- 6.Comply with all environmental regulations and other requirements.

3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

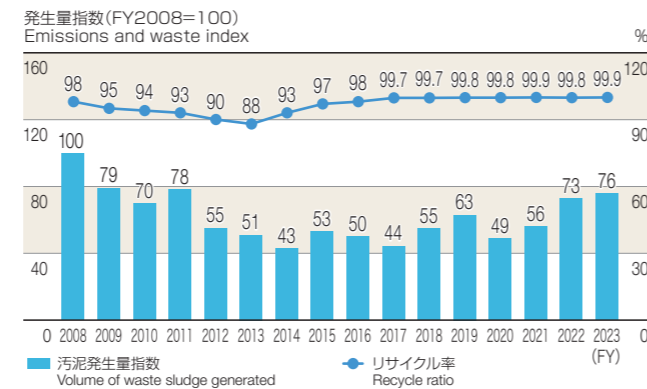
(単体) (Non-Consolidated)

## 環境負荷低減活動 Activities to Lower Environmental Impact

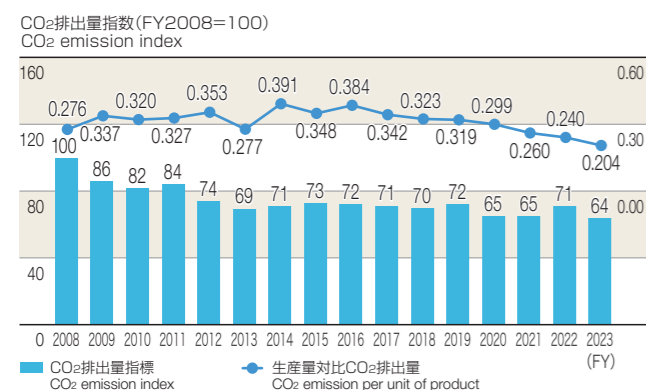
### 廃プラスチックリサイクル率 Waste Plastic Recycle Ratio



### 汚泥リサイクル率 Sludge Recycle Ratio



### CO<sub>2</sub>排出量 CO<sub>2</sub> Emissions



# 両立支援・女性活躍推進への取り組み Work-Life Balance Support and Promotion of Women's Career Activities

## 両立支援 Work-Life Balance Support

私たちは、社員が仕事と家庭を両立させることができ、より安心して働けるように両立支援の体制を整えています。全ての社員がその能力を十分に発揮できるように働きやすい環境づくりを推進しています。

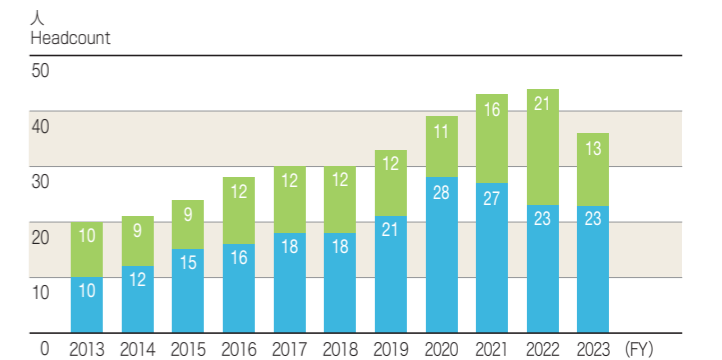
We have balance support system to enable to work with confidence for all employees. We promote to create pleasant working conditions in order to have all employees realize their potential.

### 当社の育児・介護支援の枠組み Fujimi's Support System for Childcare and Family Care

育児・介護 Support	項目 Types	法定 law	当社 FUJIMI
育児支援 Childcare Support	育児休業 Childcare leave	1歳まで(例外*:2年) Up to age 1 (exception*:age 2)	1歳6ヶ月まで(例外*:2年) Up to age 1 and half (exception*:age 2)
	時短勤務 Reduced schedule	3歳まで Up to age 3	小学校4年生修了まで Up to 4th grade elementary school
	時差勤務 Staggered work shift	妊娠中 During pregnancy	小学校4年生修了まで Up to 4th grade elementary school
介護支援 Family Care Support	介護休業 Family care leave	通算93日 Total 93 days	通算93日 Total 93 days
長期介護支援 Long-term Family Care Support	介護休業 Family care leave	なし -	通算3年間 Total 3 years

\*例外は保育所に入所できない場合  
\*Exception is applicable if the child cannot be admitted to a nursery school.

### 両立支援(育児)制度利用者数 Childcare Support System Users



女性従業員の育児休業取得率は2010年度より100%と高い水準を維持しています。  
The percentage of female employees taking childcare leave has been as high as 100% since FY2011.

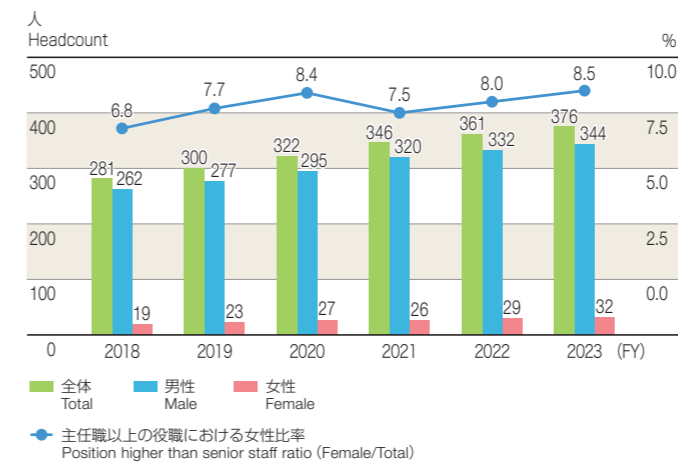
3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

## 女性活躍推進 Promotion of Women's Career Activities

私たちは、女性が活躍できる雇用環境の検討・向上に取り組んでいます。

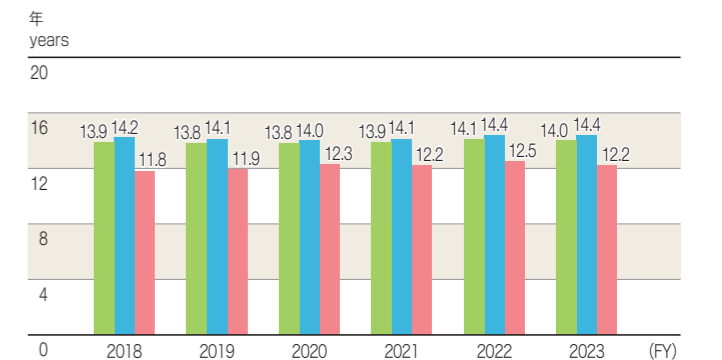
We take actions on consideration and improvement on employment conditions in order to promote women's career activities.

### 役職者数(主任職以上) Employees with Title (Position higher than Senior Staff)



主任職以上の役職における女性比率  
Position higher than senior staff ratio (Female/Total)

### 平均勤務年数 Average Years of Service



3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

# フジミのものづくりと社風・風土

## Fujimi's Manufacturing and Corporate Culture

### ものづくり Manufacturing

創業以来培ってきた独自の製造技術と自社設計の製造設備により、品質のパラッキを抑えた製品の量産体制を整えています。その一方で、お客様の高度化・多様化する要求にお応えするため、原材料の調達から生産現場、そして梱包・出荷にいたるまで一貫した少量多品種の生産体制も確立しています。

お客様にお届けする製品を信頼してご使用いただくために、厳しい製品検査と品質管理を行っています。

We have created a mass production system that reduces variations in quality through internally designed production facilities and unique production techniques cultivated since the company's founding. On the other hand, in order to respond to our customers' increasingly complex and diverse demands, we have also established a system of manufacturing small quantities of diverse products that integrates every step from the procurement of raw materials to their processing, packaging and shipping.

We conduct strict product inspections and conduct quality management to provide our customers with products they can use with confidence.



### 社風・風土 Corporate Culture

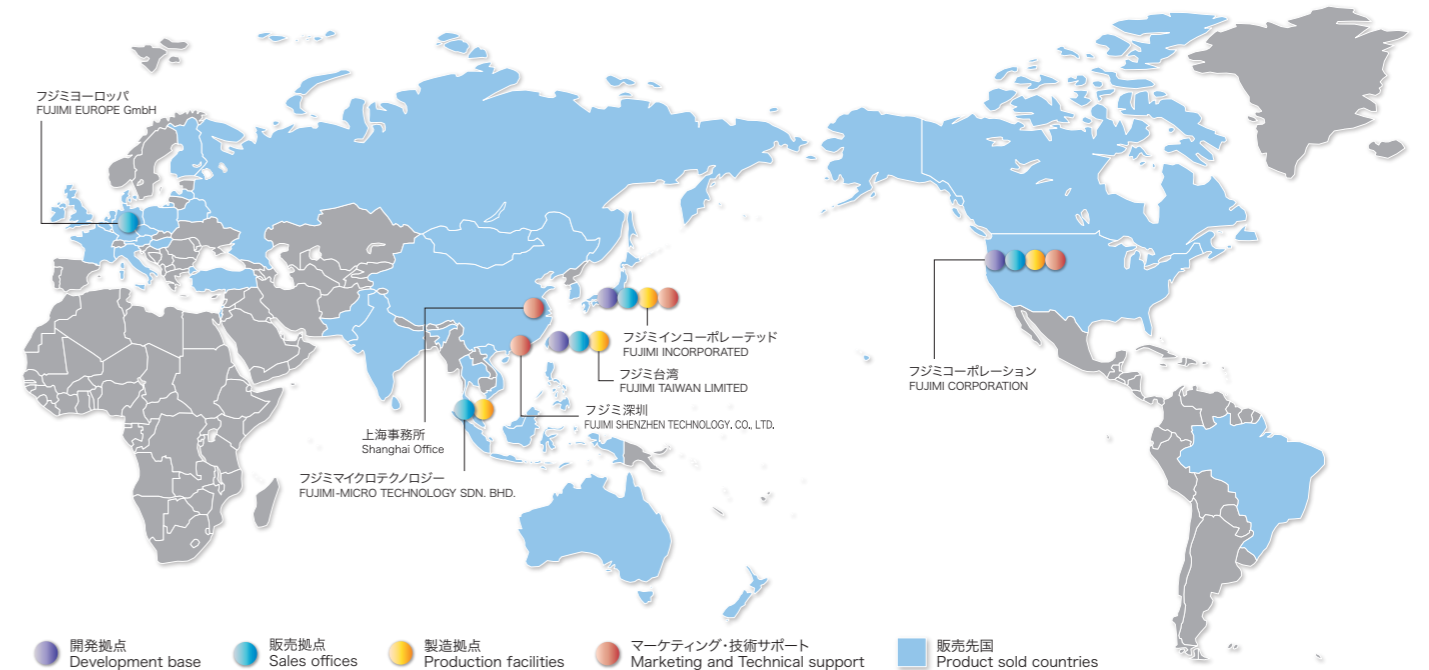
当社では、社員一人ひとりが自ら考え、自発的に行動することを求めています。年齢や職位に拘らず、自ら手を挙げチャレンジすることを奨励する社風です。教育制度では職能別の研修はもちろんのこと、一人ひとりに合ったキャリアを会社と一緒に考えるキャリアデザイン研修や、成長意欲の高い社員には社外スクールへの通学費用支援や博士等の学位取得支援も行っています。また、海外売上構成比が70%を超える当社では、語学研修にも力を入れており、希望する若手社員を対象に海外子会社へ派遣し、現地での業務を通じて語学力をはじめ対話力や提案力等の向上を支援する海外トレーニー制度もあります。高い意欲と最後までやり遂げる責任感のある社員の成長を全力でバックアップしています。

At Fujimi, each employee is asked to think independently and take action with initiative. Our corporate culture encourages those willing to raise their hands and take on challenges, regardless of age and position. In terms of educational systems, in addition to functional training, we offer career design training that considers the careers that suit each individual staff member together with the company. For highly motivated employees, we provide support for expenses to allow them to attend school outside the company, as well as support employees obtaining doctoral degrees. As our overseas sales ratio exceeds 70%, we are focusing on language training, as well as providing a training program that gives opportunities to gain experience at our overseas subsidiaries. We support motivated employees with a sentence of responsibility.



# グローバル展開

## Global Expansion



### 事務所・拠点 Plants and Offices

- 本社・枇杷島工場 Headquarters / Biwajima Plant**  
〒452-8502 愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1  
Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166  
1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi 452-8502, Japan  
Phone: +81-52-503-8181 Fax: +81-52-503-6166
- 稲沢工場 Inazawa Plant**  
〒492-8329 愛知県稲沢市西島町市助河戸 1-1  
1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa, Aichi 492-8329, Japan
- 各務原工場 Kakamigahara Plant**  
〒504-0927 岐阜県各務原市上戸町 7-1-8  
1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara, Gifu 504-0927, Japan
- 各務東町工場 Kakamihigashimachi Plant**  
〒509-0103 岐阜県各務原市各務東町 5-6-2-1  
62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu 509-0103, Japan
- 溶射材事業部 Thermal Spray Materials Department**  
〒509-0103 岐阜県各務原市各務東町 5-82-28  
82-28, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu 509-0103, Japan
- 研究開発センター R&D Center**  
〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ 1-8  
8, Technoplaza-1, Kakamigahara, Gifu 509-0109, Japan
- 先端技術研究所 Advanced Technology Research Center**  
〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ 1-22  
22, Technoplaza-1, Kakamigahara, Gifu 509-0109, Japan
- 物流センター Logistics Center**  
〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ 4-1  
1, Technoplaza-4, Kakamigahara, Gifu 509-0109, Japan
- 東京事務所 Tokyo Office**  
〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-2-8 いちご内神田ビル 7F  
7th Floor, ICHIGO Uchikanda Bldg., 2-8, Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047, Japan
- 上海事務所 Shanghai Office**  
上海市浦東区科苑路 88 号、德国中心 317B 室  
317B, German Center, 88 Keyuan Road, Pudong Zhangjiang, Hi-Tech Park, 201203, Shanghai, China

### 連結子会社 Consolidated subsidiary

- フジミコーポレーション (米国)**  
FUJIMI CORPORATION  
11200 SW Leveton Drive, Tualatin, Oregon 97062, U.S.A.  
Phone: +1-503-682-7822 Fax: +1-503-612-9721
- フジミマイクロテクノロジー (マレーシア)**  
FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.  
Lot 13, Jalan Hi-Tech 3, Industrial Zone Phase 1  
Kulim Hi-Tech Park, 09090 Kulim, Kedah Darul Aman Malaysia  
Phone: +60-4-403-3700 Fax: +60-4-403-3900
- フジミヨーロッパ (ドイツ)**  
FUJIMI EUROPE GmbH  
Schlossstrasse 5, D-74653 Ingelfingen, Germany  
Phone: +49-7940-939499-0 Fax: +49-7940-939499-20
- フジミ台湾 (台湾)**  
FUJIMI TAIWAN LIMITED  
No.10 Tongke 1st Rd., Tongluo Township, Miaoli County 366, Taiwan (R.O.C.)  
Phone: +886-37-987-123 Fax: +886-37-987-567
- フジミ深圳 (中国)**  
FUJIMI SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD.  
12A-11, Shenzhen Free Trade Center, 111 Taizi Road, Nanshan District, Shenzhen, 518067, China  
Phone: +86-755-2267-5151 Fax: +86-755-2267-5162

# 暮らしの中の FUJIMI

Fujimi's Products and  
Technology in Everyday Life

## 決済端末 (POS) Payment terminals

部品の中の水晶振動子製造過程でGCが使われています。  
GC is used for manufacturing process of crystal oscillators placed in smartphones.



## LEDライト LED lights 信号機 Traffic lights

LEDに使われるサファイア基板を磨く過程でCOMPOLが使われています。  
COMPOL is used for manufacturing process of sapphire substrates placed in LED lights.



## 飛行機 Aircrafts

フラップ・スラットレールに溶射材が使われています。  
Thermal Spray materials are used for flap-slat rails.



## 複合機 Multifunction printers

部品の中のICチップ製造過程でFO、GLANZOX、PLANERLITE等が使われています。  
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in multifunction printers.



## パソコン Personal computers

ハードディスクを磨く過程でDISKLITEが使われています。  
DISKLITE is used for manufacturing process of hard disks placed in personal computers.



## デジタルTV Digital TVs

部品の中のICチップ製造過程でFO、GLANZOX、PLANERLITE等が使われています。  
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips of digital TVs.



## 眼鏡レンズ Eyeglasses Lens

レンズを磨く過程でPOLIPLAが使われています。  
POLIPLA is used for polishing process of eyeglasses lens.



## スマートフォン Smartphones

部品の中のICチップ製造過程でFO、GLANZOX、PLANERLITE等が使われています。  
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in terminals.



## 自動車 Automobiles

ボディを磨くのにGC、WAが使われています。  
GC and WA are used for polishing process of automobile bodies.



# 10年間の財務サマリー

## Ten-Year Financial Summary

百万円 Millions of yen

項目 Item	3月31日終了の各事業年度 Fiscal years ended March 31	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>会計年度 Fiscal year</b>											
売上高	Net sales	27,492	32,815	31,755	33,092	35,788	37,394	38,408	41,956	51,731	58,394
営業利益	Operating profit	1,300	4,128	3,302	4,278	4,872	5,310	6,007	7,639	12,059	13,243
経常利益	Ordinary profit	1,535	4,596	3,342	4,519	4,728	5,637	6,177	7,709	12,490	13,595
親会社株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to owners of parent	799	3,695	2,346	3,350	3,011	4,265	4,270	5,607	9,156	10,594
設備投資額	Capital expenditures	1,094	947	1,637	1,336	1,871	1,829	2,030	1,574	1,814	2,094
研究開発費	R&D expense	2,885	3,210	3,254	3,129	3,342	3,501	3,691	4,116	4,325	4,912
減価償却費	Depreciation	2,022	1,794	1,754	1,623	1,411	1,413	1,598	1,687	1,661	1,729
<b>会計年度末 End of fiscal year</b>											
総資産	Total assets	46,648	51,779	50,675	53,698	55,439	57,848	59,496	65,773	75,684	80,101
純資産	Total net assets	41,507	44,694	44,523	46,164	47,848	50,231	52,079	56,088	62,967	69,011
負債	Total liabilities	5,140	7,084	6,151	7,534	7,591	7,616	7,416	9,684	12,717	11,089
有利子負債	Liabilities with interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from operating activities	1,044	6,491	2,869	5,785	3,671	4,397	6,232	8,743	9,301	7,377
投資活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from investing activities	(1,450)	322	1,623	(38)	(3,882)	(3,281)	(3,544)	(42)	(1,097)	(822)
財務活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from financing activities	(916)	(1,687)	(2,644)	(608)	(1,308)	(1,954)	(2,213)	(2,481)	(3,825)	(6,139)
<b>1 株当たり情報 Per share information</b>											
1株当たり当期純利益	Earnings per share (EPS)	30.82	143.79	92.63	135.77	122.16	173.07	172.98	226.85	370.38	428.05
1株当たり配当金	Cash dividends per share	30	40	40	53	63	87	87	115	185	220
配当性向 (%)	Payout Ratio (%)	97.3	27.8	43.2	39.0	51.6	50.3	50.3	50.7	49.9	51.4
1株当たり純資産額	Book value per share (BPS)	1,598.32	1,763.88	1,774.30	1,872.91	1,941.26	2,037.96	2,106.74	2,268.87	2,547.00	2,790.82
<b>主要指数 Key indicators</b>											
売上高営業利益率 (%)	Operating profit / net sales (%)	4.7	12.6	10.4	12.9	13.6	14.2	15.6	18.2	23.3	22.7
売上高経常利益率 (%)	Ordinary profit / net sales (%)	5.6	14.0	10.5	13.7	13.2	15.1	16.1	18.4	24.1	23.3
売上高当期純利益率 (%)	Return on sales (%)	2.9	11.3	7.4	10.1	8.4	11.4	11.1	13.4	17.7	18.1
自己資本当期純利益率 (ROE) (%)	Return on equity (ROE) (%)	1.9	8.6	5.3	7.4	6.4	8.7	8.3	10.4	15.4	16.1
総資産経常/営業/当期利益率 (ROA) (%)	Return on assets (ROA) (%)	1.7	7.5	4.6	6.4	5.5	7.5	7.3	9.0	12.9	13.6
自己資本比率 (%)	Equity Ratio (%)	88.87	86.32	87.86	85.97	86.31	86.83	87.53	85.28	83.20	86.16
売上高研究開発比率	R&D expense / net sales (%)	10.5	9.8	10.2	9.5	9.3	9.4	9.6	9.8	8.4	8.4
従業員 1人当たり売上高	Net sales per employee	35.40	41.12	39.16	40.02	42.40	43.43	42.30	43.80	52.78	56.63
従業員数 (人)	Number of employees	775	798	811	827	844	861	908	958	980	1,031
発行済株式数 (千株)	Number of issued shares (Thousands of shares)	30,699	29,699	29,699	28,699	28,699	28,699	28,699	28,699	28,699	26,699

# 経営指標

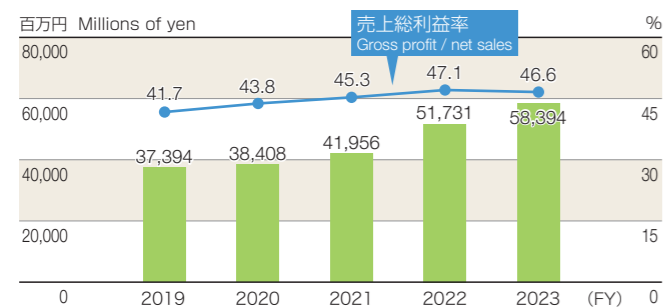
## Selected Financial Data

3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

### 収益性 Profitability

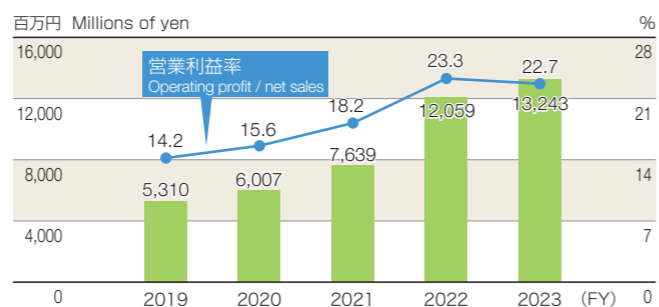
#### 売上高/売上総利益率

##### Net Sales and Gross Profit / Net Sales



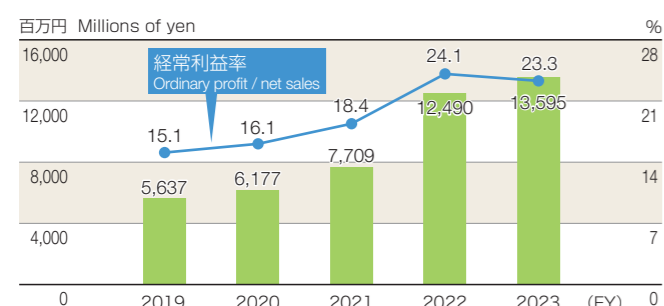
#### 営業利益/営業利益率

##### Operating Profit and Operating Profit / Net Sales



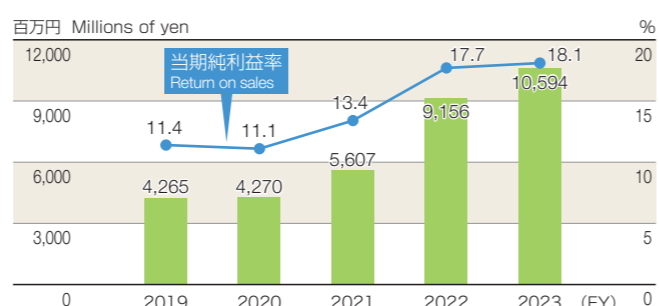
#### 経常利益/経常利益率

##### Ordinary Profit and Ordinary Profit / Net Sales



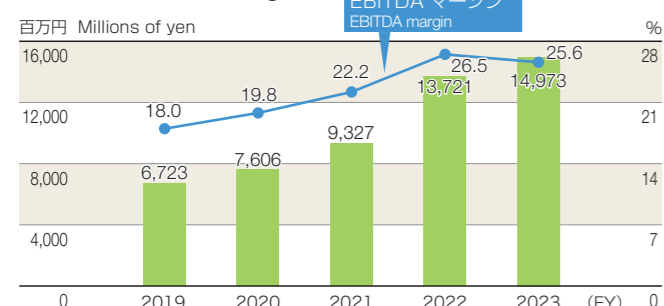
#### 親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益率

##### Profit Attributable to Owners of Parent and Return on Sales



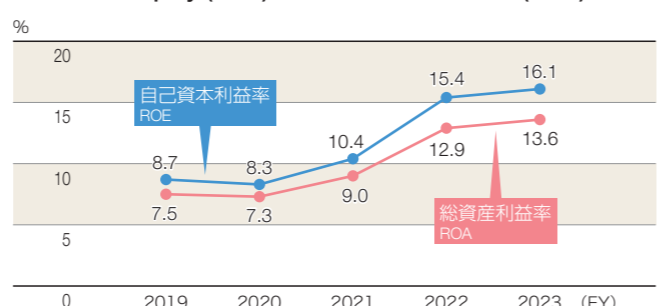
#### EBITDA/EBITDAマージン

##### EBITDA / EBITDA Margin



#### 自己資本利益率/総資産利益率

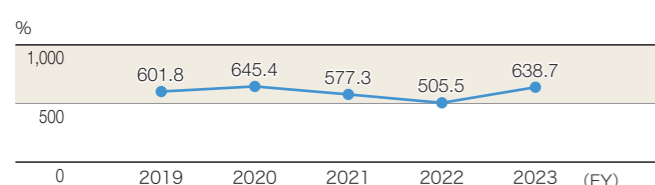
##### Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)



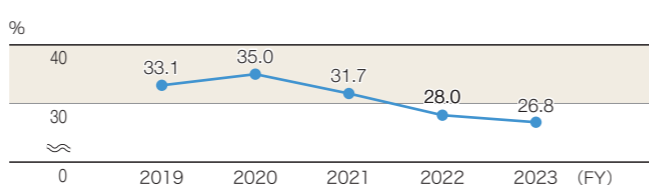
3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

### 安定性 Stability

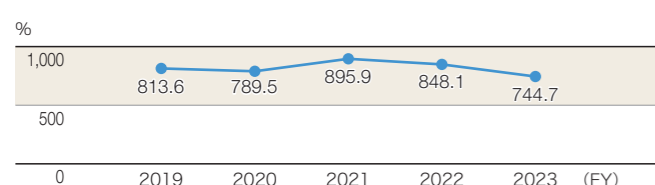
#### 流動比率 Current Ratio



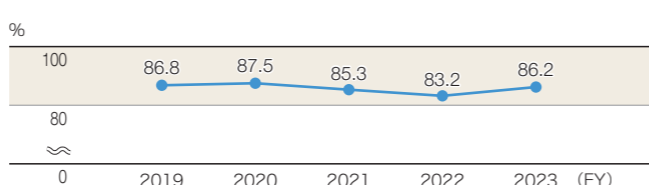
#### 固定比率 Non-current Assets Ratio



#### 手元流動性比率 Short-Term Liquidity

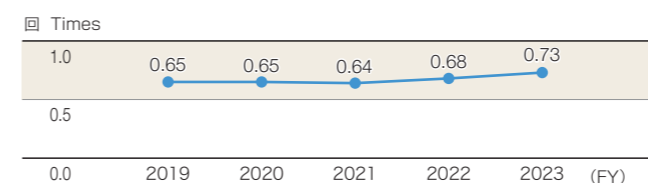


#### 自己資本比率 Equity Ratio

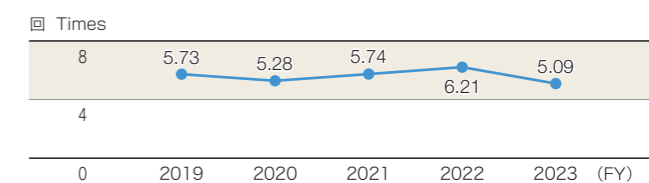


### 生産性/効率性 Productivity and Efficiency

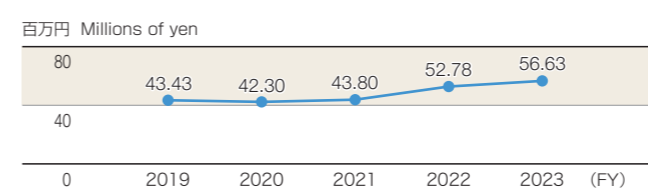
#### 総資産回転率 Total Asset Turnover



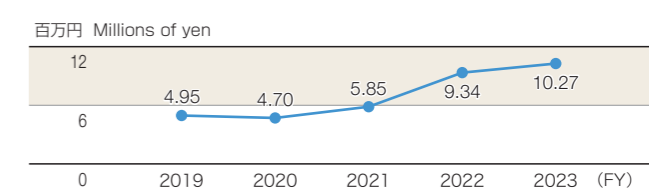
#### たな卸資産回転率 Inventory Turnover



#### 従業員1人当たり売上高 Net Sales per Employee



#### 従業員1人当たり当期純利益 Net Income per Employee

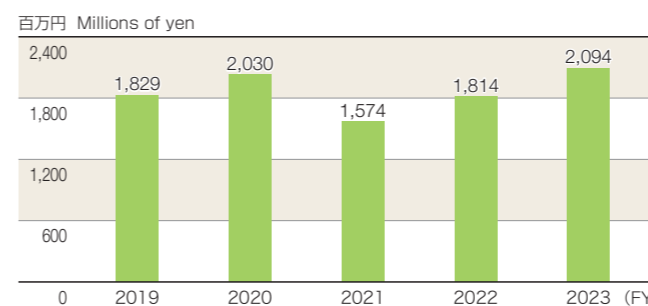


3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

### 設備投資/研究開発 Capital Expenditures / Research and Development

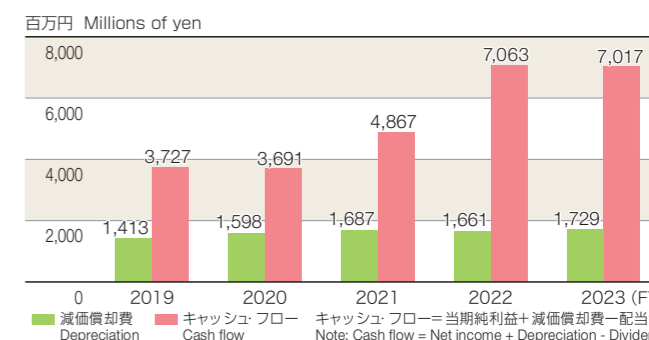
#### 設備投資

##### Capital Expenditures



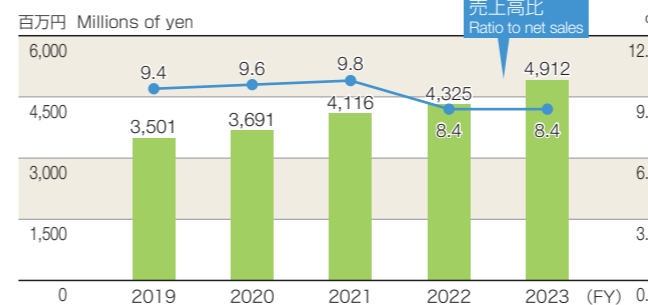
#### 減価償却費/キャッシュ・フロー

##### Depreciation and Cash Flow



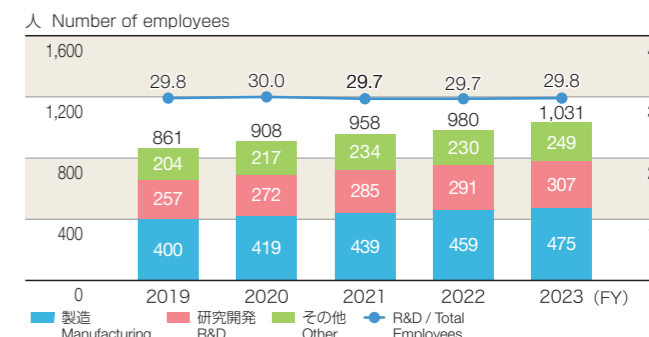
#### 研究開発費/売上高比

##### R&D Expense and Ratio to Net Sales



#### 研究開発要員

##### Number of Employees - R&D / Total -

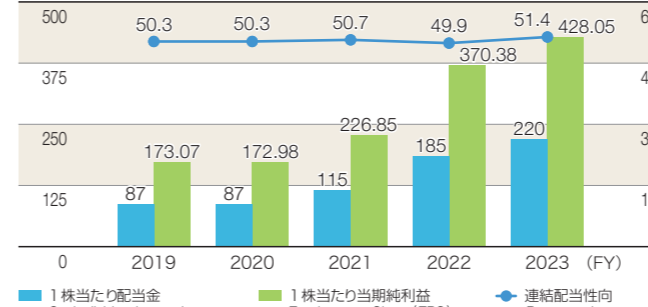


3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

### 投資指標 Per Share Data and Others

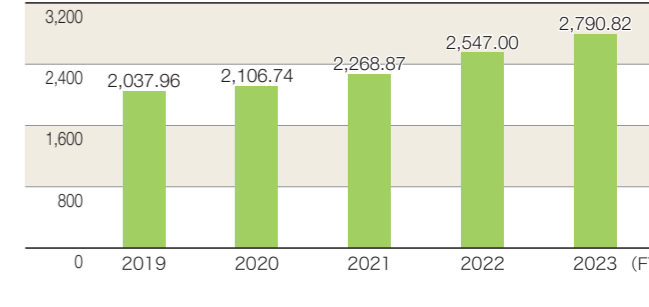
#### 1株当たり配当金/1株当たり当期純利益/連結配当性向

##### Cash Dividends per Share, Earnings per Share (EPS), Payout Ratio



#### 1株当たり純資産

##### Book Value per Share (BPS)



# 連結貸借対照表

## Consolidated Balance Sheet

百万円 Millions of yen

		各年 3 月 31 日現在 As of March 31	
		2022	2023
<b>資産の部</b>	<b>Assets</b>		
流動資産	Current assets		
現金及び預金	Cash and deposits	31,662	33,538
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable-trade	11,581	11,246
有価証券	Securities	4,900	2,700
商品及び製品	Merchandise and finished goods	4,569	5,820
仕掛品	Work in process	1,041	1,451
原材料及び貯蔵品	Raw materials and supplies	3,714	6,329
その他	Other	595	552
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(15)	(16)
流動資産合計	Total current assets	58,049	61,623
固定資産	Non-current assets		
有形固定資産	Property, plant and equipment		
建物及び構築物（純額）	Buildings and structures, net	6,528	6,661
機械装置及び運搬具（純額）	Machinery, equipment and vehicles, net	1,732	1,803
土地	Land	3,585	3,598
建設仮勘定	Construction in progress	1,102	1,137
その他（純額）	Other, net	1,276	1,626
有形固定資産合計	Total property, plant and equipment	14,225	14,827
無形固定資産	Intangible assets		
ソフトウェア	Software	316	215
その他	Other	33	26
無形固定資産合計	Total intangible assets	349	241
投資その他の資産	Investments and other assets		
投資有価証券	Investment securities	1,844	2,282
繰延税金資産	Deferred tax assets	1,108	987
その他	Other	116	149
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(9)	(9)
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	3,059	3,409
固定資産合計	Total non-current assets	17,634	18,478
資産合計	Total assets	75,684	80,101

百万円 Millions of yen

		各年 3 月 31 日現在 As of March 31	
		2022	2023
<b>負債の部</b>	<b>Liabilities</b>		
流動負債	Current liabilities		
買掛金	Accounts payable – trade	3,986	4,247
未払法人税等	Income taxes payable	2,307	891
賞与引当金	Provision for bonuses	1,395	1,354
株式給付引当金	Provision for share-based remuneration	796	—
その他	Other	2,999	3,154
流動負債合計	Total current liabilities	11,484	9,648
固定負債	Non-current liabilities		
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	3	3
退職給付に係る負債	Net defined benefit liability	903	925
株式給付引当金	Provision for share-based remuneration	43	191
その他	Other	282	321
固定負債合計	Total non-current liabilities	1,232	1,441
負債合計	Total liabilities	12,717	11,089
<b>純資産の部</b>	<b>Net assets</b>		
株主資本	Shareholders' equity		
資本金	Capital stock	4,753	4,753
資本剰余金	Capital surplus	6,878	5,038
利益剰余金	Retained earnings	55,705	60,310
自己株式	Treasury shares	(6,753)	(4,414)
株主資本合計	Total shareholders' equity	60,584	65,688
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income		
その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	390	410
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	2,072	2,998
その他	Other	(79)	(85)
その他の包括利益累計額合計	Total accumulated other comprehensive income	2,383	3,323
純資産合計	Total net assets	62,967	69,011
負債純資産合計	Total liabilities and net assets	75,684	80,101

## 連結損益計算書

### Consolidated Statement of Income

百万円 Millions of yen

		3月31日終了の各事業年度 Fiscal years ended March 31	
		2022	2023
売上高	Net sales	51,731	58,394
売上原価	Cost of sales	27,343	31,206
売上総利益	Gross profit	24,388	27,187
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	12,328	13,944
営業利益	Operating profit	12,059	13,243
営業外収益	Non-operating income		
受取利息	Interest income	49	95
受取配当金	Dividend income	31	46
為替差益	Foreign exchange gains	183	322
その他	Other	209	85
営業外収益合計	Total non-operating income	473	550
営業外費用	Non-operating expenses	42	198
経常利益	Ordinary profit	12,490	13,595
特別損失	Extraordinary losses	108	88
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	12,382	13,507
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	3,247	2,797
法人税等調整額	Income taxes-deferred	(21)	115
親会社株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to owners of parent	9,156	10,594

## 連結包括利益計算書

### Consolidated Statement of Comprehensive Income

百万円 Millions of yen

		3月31日終了の各事業年度 Fiscal years ended March 31	
		2022	2023
当期純利益	Profit	9,156	10,594
その他の包括利益	Other comprehensive income		
その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	69	19
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	1,386	925
退職給付に係る調整額	Remeasurements of defined benefit plans, net of tax	18	(5)
その他の包括利益合計	Total other comprehensive income	1,474	939
包括利益	Comprehensive income	10,631	11,534
(内訳)	Breakdown		
親会社株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to owners of parent	10,631	11,534

## 連結キャッシュ・フロー計算書

### Consolidated Statement of Cash Flows

百万円 Millions of yen

		3月31日終了の各事業年度 Fiscal years ended March 31	
		2022	2023
営業活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from operating activities	9,301	7,377
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	12,382	13,507
減価償却費	Depreciation	1,661	1,729
長期前払費用償却額	Amortization of long-term prepaid expenses	0	1
システム障害対応費用	System failure response costs	103	88
賞与引当金の増減額（減少）	Increase (decrease) in provision for bonuses	(63)	(50)
貸倒引当金の増減額（減少）	Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts	1	1
退職給付に係る負債の増減額（減少）	Increase (decrease) in retirement benefit liability	28	14
株式給付引当金の増減額（減少）	Increase (decrease) in provision for share-based remuneration	509	(647)
受取利息	Interest income	(49)	(95)
受取配当金	Dividend income	(31)	(46)
支払利息	Interest expenses	6	7
為替差損益（益）	Foreign exchange losses (gains)	(39)	(74)
投資有価証券評価損益（益）	Loss (gain) on valuation of investment securities	—	42
投資事業組合運用損益（益）	Loss (gain) on investments in partnership	18	138
売上債権の増減額（増加）	Decrease (increase) in trade receivables	(2,123)	572
棚卸資産の増減額（増加）	Decrease (increase) in inventories	(1,701)	(4,077)
仕入債務の増減額（減少）	Increase (decrease) in trade payables	826	97
未払金の増減額（減少）	Increase (decrease) in accounts payable - other	21	208
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends received	82	141
法人税等の支払額	Income taxes paid	(2,360)	(4,299)
法人税等の還付額	Income taxes refund	77	84
システム障害対応費用の支払額	System failure response costs paid	(56)	(38)
その他	Other, net	6	70
投資活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from investing activities	(1,097)	(822)
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	(4,011)	(3,006)
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	4,461	3,647
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	100	901
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	(101)	(614)
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	(1,562)	(1,751)
無形固定資産の取得による支出	Purchase of intangible assets	(54)	(11)
その他	Other, net	70	13
財務活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from financing activities	(3,825)	(6,139)
配当金の支払額	Dividends paid	(3,754)	(5,306)
自己株式の取得による支出	Purchase of treasury shares	(1,612)	(740)
自己株式の処分による収入	Proceeds from disposal of treasury shares	1,610	—
その他	Other, net	(69)	(91)
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	606	513
現金及び現金同等物の増減額（減少）	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	4,984	929
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	29,418	34,402
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	34,402	35,332

# 沿革 History

年 Year	内容	Event
1950	不二見研磨材工業所創業、日本国内初の研磨微粉の製造開始	Founded Fujimi Abrasives and started production of synthetic precision abrasives.
1953	不二見研磨材工業(株)を設立	Established Fujimi Abrasives Manufacturing Co., Ltd.
1957	愛知県清須市に枇杷島工場を建設	Commenced operations at the Biwajima Plant. (Aichi prefecture)
1959	本社所在地を愛知県清須市に移転	Moved headquarters to current location. (Aichi prefecture)
1970	愛知県稲沢市に稲沢工場を建設	Commenced operations at the Inazawa Plant. (Aichi prefecture)
1984	米国イリノイ州にFUJIMI CORPORATIONを設立	Established FUJIMI CORPORATION in Illinois, U.S.A.
1985	岐阜県各務原市に各務原工場を建設	Commenced operations at the Kakamigahara Plant. (Gifu prefecture)
1988	米国オレゴン州にFUJIMI AMERICA INC.を設立	Established FUJIMI AMERICA INC. in Oregon, U.S.A.
1991	社名を現社名(株)フジミインコーポレーテッドに変更	Fujimi Abrasives Manufacturing Co.,Ltd was renamed Fujimi Incorporated.
1995	マレーシアにFUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHDを設立	Established FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD. in Malaysia
1996	岐阜県各務原市に各務東町工場を建設	Commenced operations at the Kakamihigashimachi Plant. (Gifu prefecture)
1999	岐阜県各務原市に物流センターを建設	Commenced operations at logistics center. (Gifu prefecture)
2000	岐阜県各務原市に溶射材事業部棟を建設	Commenced operations at Thermal spray materials business Plant. (Gifu prefecture)
2000	岐阜県各務原市に研究開発センターが完成	Commenced operations at R&D center. (Gifu prefecture)
2003	FUJIMI AMERICA INC. はFUJIMI CORPORATIONと合併。商号をFUJIMI CORPORATION(米国オレゴン州)に変更	FUJIMI AMERICA INC. and FUJIMI CORPORATION merge under the name FUJIMI CORPORATION. (Oregon, USA)
2004	英国にFUJIMI EUROPE LIMITEDを、独国内にFUJIMI EUROPE GmbHを設立	Established FUJIMI EUROPE LIMITED in England and FUJIMI EUROPE GmbH in Germany.
2005	台湾に駐在員事務所を開設	Established an office in Taiwan.
2007	東証一部、名証一部に同時上場	Listed Fujimi's shares on the Tokyo Stock Exchange First Section and Nagoya Stock Exchange First Section
2007	中国上海市に駐在員事務所を開設	Established an office in Shanghai, China
2007	岐阜県各務原市に各務東町工場第2棟を建設	Commenced operations at the No.2 Kakamihigashimachi Plant. (Gifu prefecture)
2008	韓国に駐在員事務所を開設	Established an office in Korea.
2010	FUJIMI EUROPE LIMITED(英国)はFUJIMI EUROPE GmbH(独国内)に統合	FUJIMI EUROPE LIMITED and FUJIMI EUROPE GmbH were merged, with FUJIMI EUROPE GmbH as the surviving company
2011	台湾にFUJIMI TAIWAN LIMITEDを設立	Established FUJIMI TAIWAN LIMITED
2013	韓国にFUJIMI KOREA LIMITEDを設立	Established FUJIMI KOREA LIMITED
2015	中国深圳市にFUJIMI SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD.を設立	Established FUJIMI SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD. in Shenzhen, China
2015	岐阜県各務原市に先端技術研究所を設立	Commenced operations at Advanced Tchnology Research Center. (Gifu prefecture)
2022	東京証券取引所のプライム市場に移行	Transition to Prime Market in the Tokyo Stock Exchange.
2022	名古屋証券取引所のプレミアム市場に移行	Transition to Premier Market in the Nagoya Stock Exchange.

# 会社データ Corporate Data

2023年3月31日現在	As of March 31, 2023
商号 Name	株式会社フジミインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED
設立年月日 Date of establishment	1953年3月20日 March 20, 1953
資本金 Paid-in capital	¥4,753,438,500
従業員数 Number of employees	1,031名 (単体 732) Non-Consolidated
上場市場 Securities traded	東京証券取引所プライム市場 Tokyo Stock Exchange, Prime Market 名古屋証券取引所プレミアム市場 Nagoya Stock Exchange, Premier Market 証券コード 5384 Code 5384

## 大株主一覧 Leading Shareholders

株主名 Name of Shareholder	持株数*1 (千株) Number of Shares Owned (Thousands of Shares)	持株比率*2 (%) Shareholding ratio	
有限会社コマ	Koma Co.,Ltd.	4,460	17.7
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust Account)	2,732	10.8
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	1,507	5.9
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	1,425	5.6
株式会社三菱UFJ銀行	MUFG Bank, Ltd.	728	2.8
フジミ取引先持株会	Fujimi Suppliers' Stock Ownership Program	649	2.5
日本生命保険相互会社	Nippon Life Insurance Co.	639	2.5
一般財団法人越山科学技術振興財団	The Koshiyama Science and Technology Foundation	600	2.3
株式会社かんぽ生命保険	JAPAN POST INSURANCE Co., Ltd.	475	1.8
第一生命保険株式会社	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	472	1.8

\*1 持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てています。  
Shareholdings of less than 1,000 shares are omitted. Percentage shareholding is omitted after the second decimal place.  
\*2 持株比率は、自己株式(1,548,464株)を控除して計算しております。  
The shareholding ratio is calculated by excluding the number of shares of treasury shares (1,548,464shares).

## 所有者別分布状況 Composition of Shareholders by Category

